タツモ株式会社 決算説明資料

2021年12月期第1四半期

2021年5月14日発表 タツモ株式会社



会社概要 TAZMO

本社所在地

社名 タツモ株式会社

設立 1972年 (昭和47年) 2月26日

本社所在地 岡山県岡山市北区芳賀5311

資本金 27億2,406万7,238円

従業員数 単体 342名/連結 1,061名 (2020年12月31日現在)

事業内容 半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、液晶製造装置、

紫外線照射装置、めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品

などの開発・製造・販売

1972	電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
1980	インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
	半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
1989	液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
1990	本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
	スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
1994	エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
1995	インジェクション成形品の製造・販売を開始
2001	半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
2004	JASDAQ市場に株式を上場
2008	TAZMO VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム:ホーチミン市)を設立

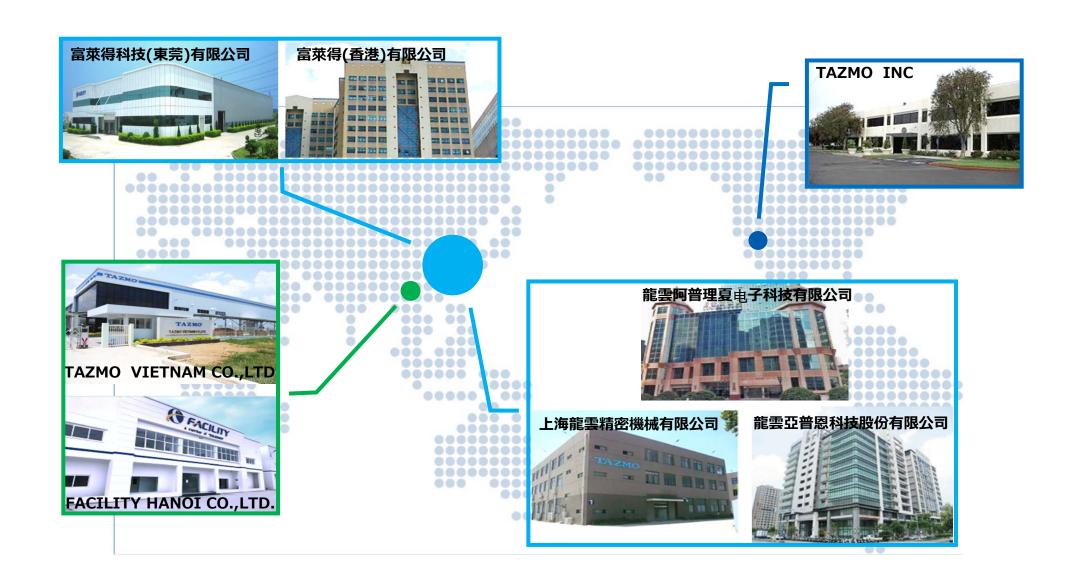


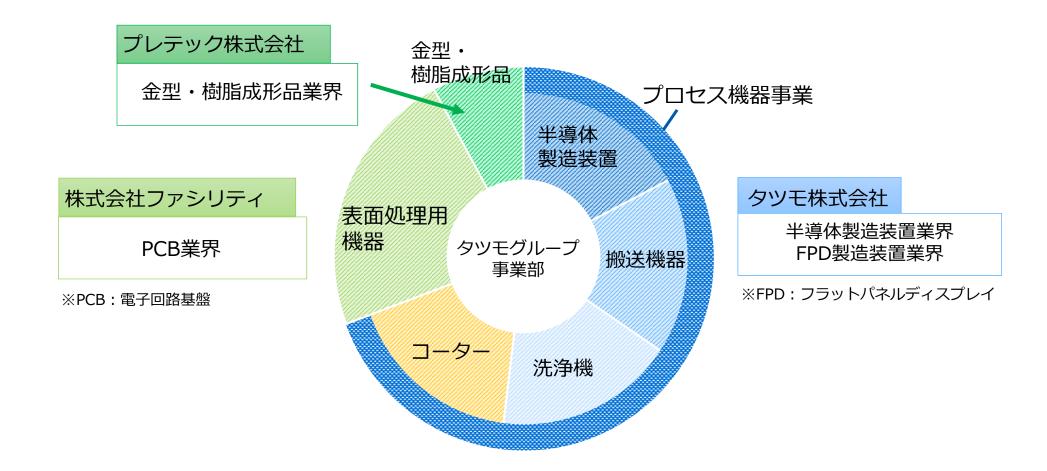
2009	第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
	3 M社(米国)と半導体製造装置のライセンス契約を締結
2013	アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
	ロンアン省ロンパウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
2015	第三者割当増資により、資本金16億1,683万円へ増資
2016	タツモ岡山技術センターを開設
2017	株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化
2018	東京証券取引所市場第一部へ市場変更
	新株式発行により、資本金27億2,406万円へ増資
2019	本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
2020	アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併











半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、 シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを 仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売







半導体製造装置に用いられるシリコンウェー八等搬送ロボットや アライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した 製品等の開発・製造・販売





洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、 スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売







コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発・製造・販売





金型·樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使った コネクター等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売

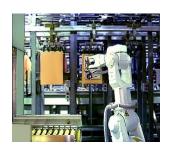




表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の 開発・製造・販売



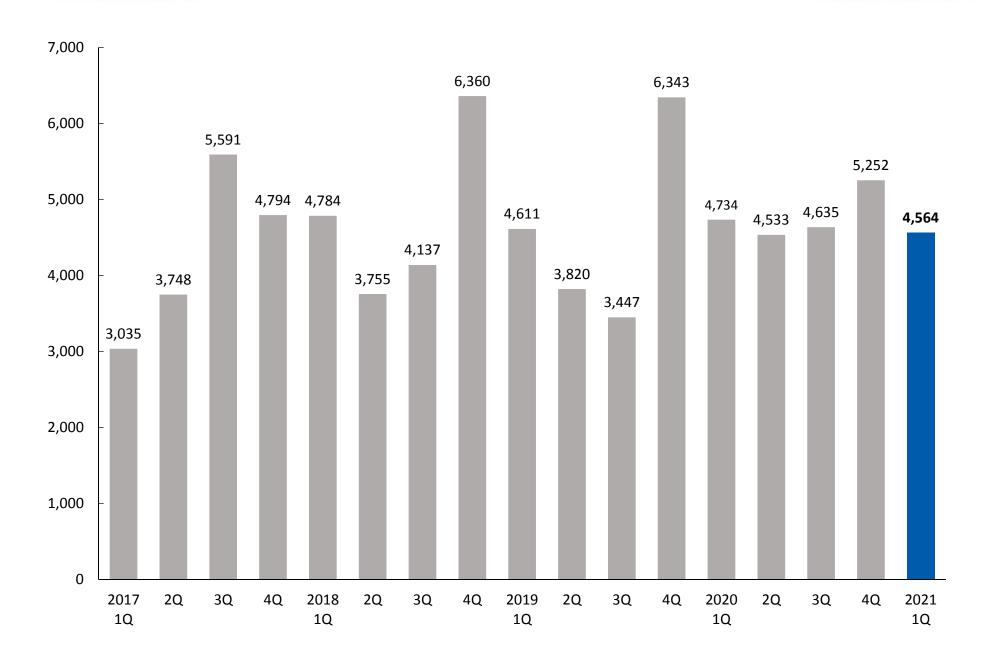


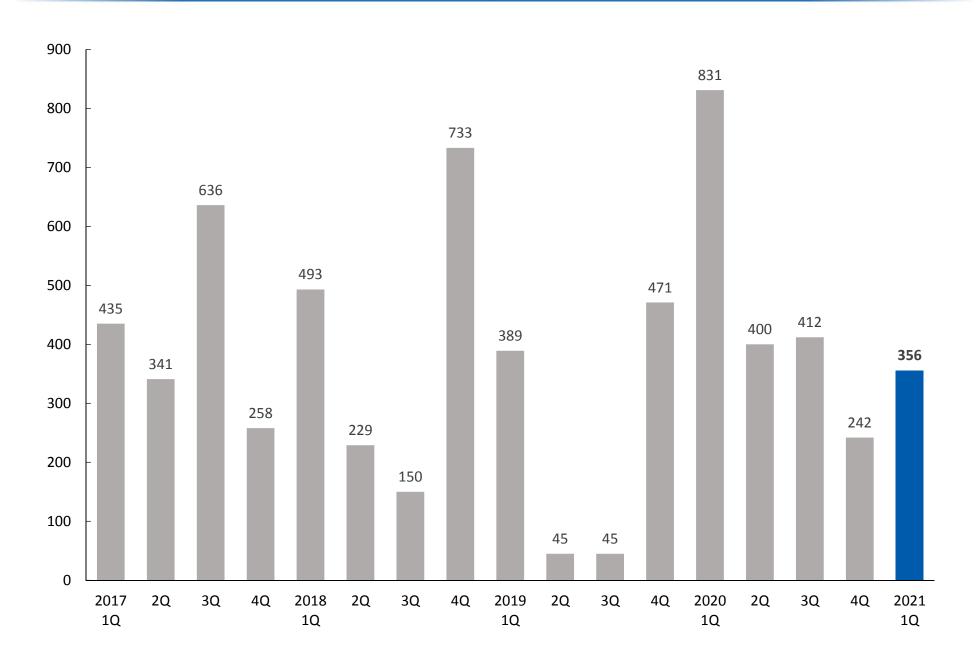
連結業績

	単位:百	百万円		′20年 1Q	′21年 1Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
売	T	- -	高	4,734	4,564	_	21,376	21.3
売	上 総	8 利	益	1,683	1,213	26.6	_	_
販	管	-	費	851	857	18.8	_	_
営	業	利	益	831	356	7.8	1,767	20.1
経	常	利	益	810	413	9.1	1,724	23.9
親会四	会社株主 半 期	に帰属 ⁻ 純 利	する 益	599	279	6.1	1,220	22.8

売上高は前年同期比で同程度であったが、売上製品ミックスの変動により前年同期比で利益 率が悪化

前年からの検収遅れ、今年度2Qに計画していた案件の売上前倒しなどにより、年初計画より上振れで推移



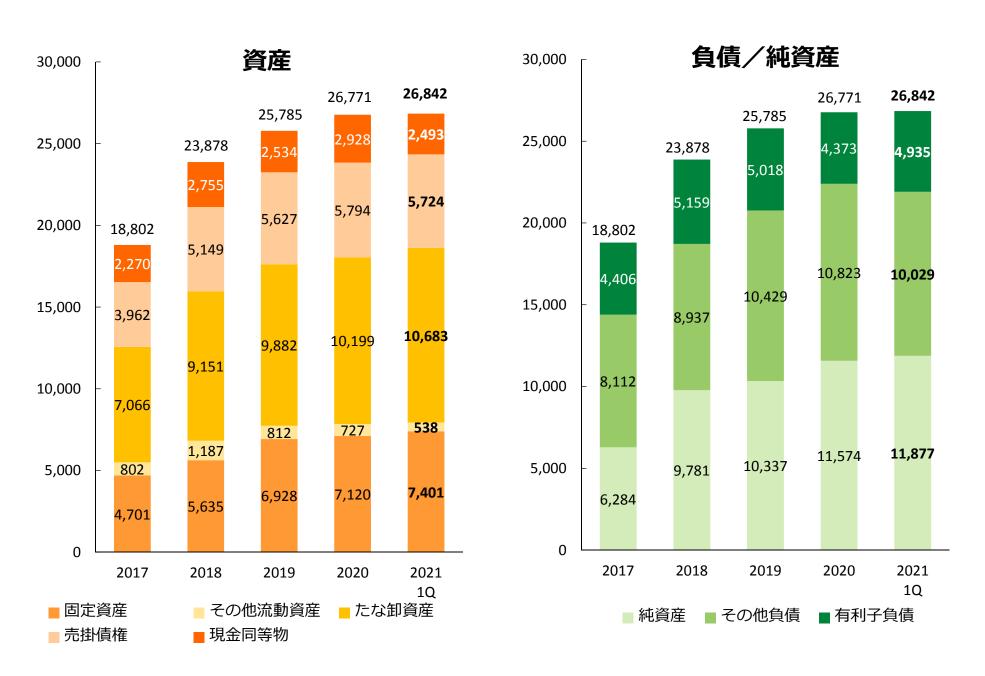


単位:百万円	′20年12月期	'21年1Q	増減
流動資産	19,650	19,441	△209
有形固定資産	5,788	5,867	78
無形固定資産	171	165	△6
投資その他資産	1,160	1,369	208
総 資 産	26,771	26,842	71
流動負債	12,154	12,180	26
固定負債	3,042	2,784	△257
純 資 産	11,574	11,877	303
自己資本比率	42.6%	43.6%	1.0P

主な増減						
資産						
	'21年1Q	前期末比				
現金及び預金	2,493	△435				
受取手形及び売掛金	3,832	418				
電子記録債権	1,892	△488				
たな卸資産	10,683	484				
	負債					
	'21年1Q	前期末比				
電子記録債務	1,671	△407				
1年内償還予定の社債	300	300				
短期借入金	2,535	487				
前受金	4,337	△372				
長期借入金	2,099	74				



単位:百万円



単位:百万円	′20年 1Q	′21年 1Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
売上高	4,734	4,564	_	21,376	21.3
プロセス機器事業	3,494	3,568	78.1	16,346	21.8
半導体装置	1,657	383	8.3	4,148	9.2
搬送機器	1,109	1,382	30.2	4,296	32.1
洗浄機	592	938	20.5	4,129	22.7
コーター	134	864	18.9	3,772	22.9
金型・樹脂成形事業	366	369	8.1	1,474	25.0
表面処理用機器事業	873	626	13.7	3,555	17.6

半導体装置: 当期売上予定案件が少なかったため前年同期比で76.9%減少。

搬送機器 : '20年3Qから受注好調、ベトナム子会社も好調に推移 前年同期比24.6%増

洗浄機 : '20年の未検収分の売上計上により前年同期比58.5%増

コーター: '20年未検収分及び2Q予定分の売上計上により、前年同期比544.8%増

単位:百万円	′20年 1Q	′21年 1Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
営業利益	831	356	7.8	1,767	20.1
プロセス機器事業	759	299	6.6	1,575	18.9
金型・樹脂成形事業	7	32	0.7	31	103.2
表面処理用機器事業	57	24	0.5	161	14.9
セグメント間連結消去	7	0	_	_	_

プロセス機器事業 : 半導体装置の売上減少により利益率が低下 前年同期比60.6%減

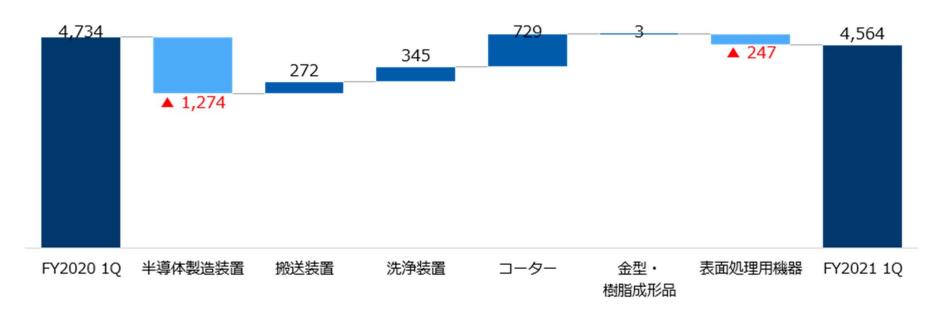
金型・樹脂成形事業:コネクター成形が好調 上海子会社のコネクター組立回復 前年同期

比357.1%增

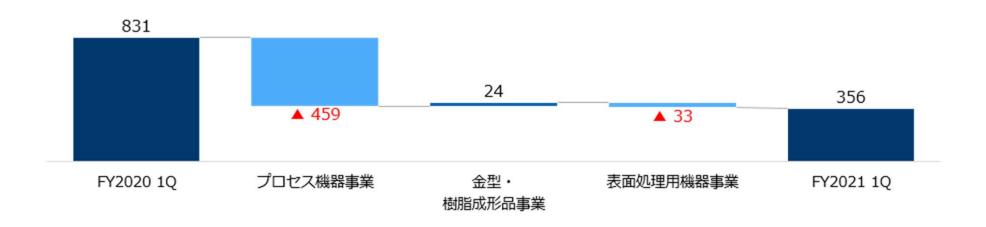
表面処理用機器事業:売上減少により前年同期比57.9%減



売上高

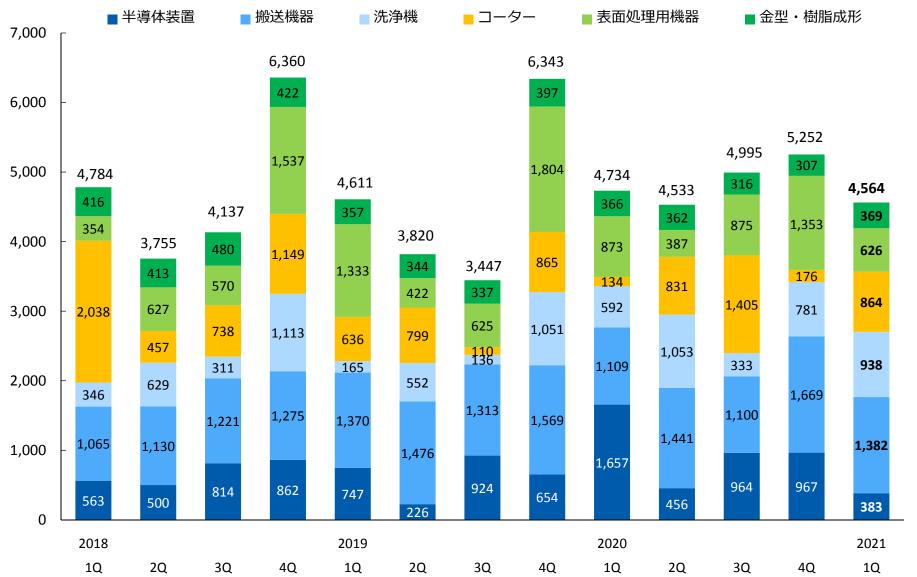


営業利益



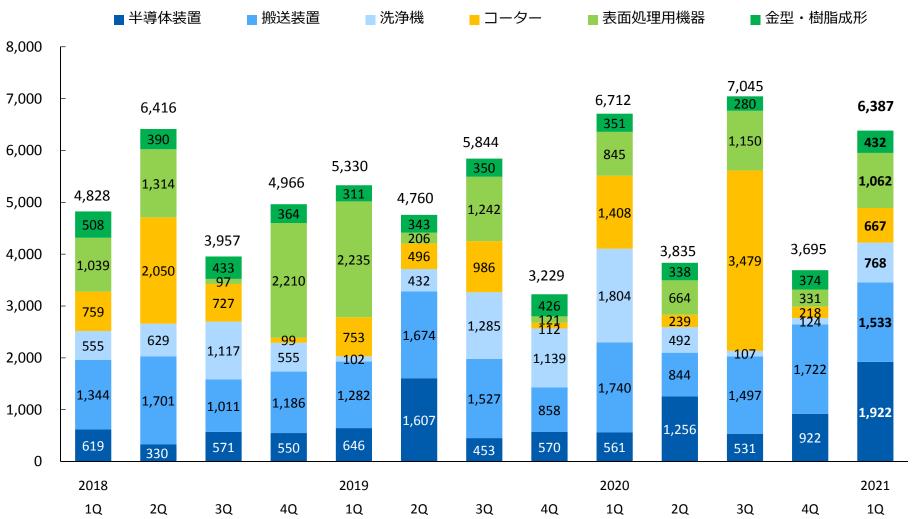


単位:百万円





単位:百万円

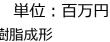


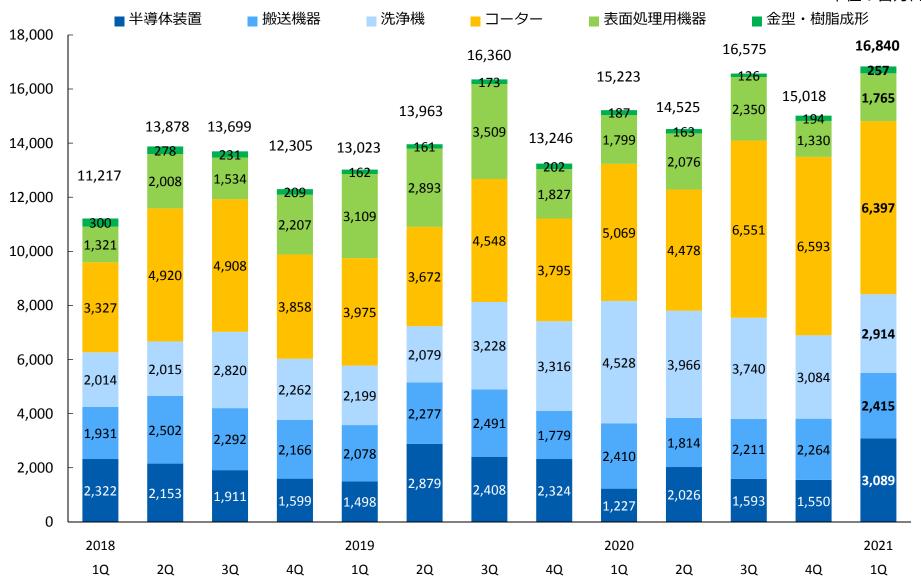
プロセス機器事業 : 半導体装置及び搬送機器の受注好調。強い引合が継続中。

表面処理用機器事業:引合・受注が回復傾向。

金型・樹脂成形事業:コネクター関係の受注好調。







- プロセス機器事業で半導体業界の好況による設備投資に牽引され、半導体装置、搬送機器の受注好調。
- ▶ 半導体装置は台湾OSAT向けコーター/デベロッパが昨年に引き続き大口受注。パワー半導体向け貼合・剥離装置の受注・引合増加中。先端パッケージ向け装置も追加受注と製造キャパシティが一杯になりつつある。
- ▶ 搬送機器でも製造・検査工程でキャパシティが一杯であり、工程管理の徹底・ベトナム生産品目の増加などで対応。
- ▶ ナノインプリント用装置の引合いも強く、早期の量産用デモ機の製作が必須。
- ⇒ 部品の入手が難しくなってきており、部品在庫を増やし納期による失注を防ぐ。
- ▶ 金型・樹脂成形でも民生品用コネクターの需要が増加している。交代勤務で生産している。樹脂材料も調達が難しくなっている。
- ▶ 表面処理用機器事業では引合が回復傾向にあり、確実な受注を目指す。

本資料の取扱上の注意

本資料は、2021年5月14日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載されて無いように基づいて 被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承くださ い。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

TEL 086-239-5000

FAX 086-239-5100

Email keiki@tazmo.co.jp



TAZMO